

SEMI-e 2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | SEMI-e 2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会 |
| 公司名称 | 广州市华亚展览服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路66号 |
| 联系电话 | 18620712559 |

产品详情

SEMI-e 2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

时间：2024年6月26日-28日

地点：深圳国际会展中心4/6/8号馆

展出面积：60000平方米

参展企业：800+

参观观众：60000人

主题活动：40余场

展会介绍：

深圳国际半导体技术暨应用展览会（展会简称：SEMI-e）是由中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、深圳市中新材会展有限公司、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会等单位联合主办。

第六届SEMI-e以【“芯”中有“算”·智享未来】为主题，60,000平方米展出面积，800余家展商，预计观众人数达60,000+。本届展会展示以芯片设计及制造、半导体制造、封测、材料和设备、零部件及检测外，突出AI算力、算法、存储、工业控制、汽车智能化、物联网、AI医疗、教育、智慧能源控制等各种*新应用解决方案。

上届SEMI-e展览面积超40,000m²，集结643家展商，展品涵盖电子元器件、IC设计&芯片、晶圆制造及封装、Mini/Micro-LED、半导体设备、半导体材料、第三代半导体7大领域，同期举办40+主题活动，吸引来自半导体行业、汽车新能源、消费电子、医疗和工控等领域40,757人到场参观交流，累计73,646参观人

次。长电科技、华天科技、通富微电、华进半导体、捷捷微电、江波龙、比亚迪、三环集团、时创意、金泰克、敦泰科技、合科泰、沛顿、无锡芯享、英诺赛科、基本半导体、镓未来、天域半导体、烁科晶体、瀚天天成、河北普兴、森国科、镓未来、江苏能华微、聚能创芯、晟光硅研、上海微电子装备、华工激光、凯格精机、新益昌开玖、劲拓/思立康、宇环数控、联得半导体、基恩士、高视、视清科技、猎奇智能、正业科技、埃芯、汉虹精密、纳设智能、思泰克、恩纳基、明治传感器、THK、华卓精科、森美协尔等企业均在本届展会中全面展示了半导体行业的新技术、新产品、新亮点、新趋势，构建起半导体产业交流融合的新生态。

其中，安世半导体、比亚迪半导体、富士康、华为、嘉德新能源、亚科电子、中兴通讯、长安新科等企业组团莅临现场，另有扬杰科技、东微半导体、斯达半导体、中芯国际、英飞凌、中车时代、天科合达、长江存储、华润微、广汽集团、英特尔、微软中国、腾讯、比亚迪、安森美、神龙汽车、小米汽车、一汽丰田、寒武纪、紫光展锐、中芯微、地平线、中科芯（中电第五十八研究所）、兆易创新、华润微电子、华虹、圣邦微、新洁能、集创北方、TCL华星、三安光电、中车时代、天科合达、士兰微、日月光、平头哥、意法半导体、一汽大众、索尼、OPPO、中国电建集团江西电建、天岳先进、时代电气等专业买家代表均莅临本届展会，零距离探秘科技魅力，助力半导体行业的创新发展。

组织机构

主办单位：中国通信工业协会、浙江省半导体行业协会、江苏省半导体行业学会、深圳市半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

承办单位：：深圳市中新材会展有限公司、上海弗迪展览有限公司

展品范围：

电子元器件展区：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇电声器件、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

IC设计、芯片展区：IC及相关电子产品设计、人工智能芯片、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等

第三代半导体展区：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件（发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外）、电力电子器件（二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GT O、ETO、SBD、HEMT等）、微波射频器件（HEMT、MMIC）

半导体设备展区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、回流焊，波峰焊、测试机、分选机、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等

半导体材料展区：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、晶圆胶带、光掩膜版、电子气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等

晶圆制造及封装展区：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板及设备以及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备

展会亮点：

一对一采购对接会：一对一采购对接会是主办方通过展前联系有明确采购需求和供应商储备需求的VIP特邀买家，并根据采购需求提供匹配的展商列表，确定展会期间需要洽谈的展商，从而帮助我们的VIP特邀买家在展前就确定现场的商务洽谈名单、观展线路，以及参会行程单，提升VIP特邀买家的观展效率以及参展商与买家精准对接。

完整产业链：以芯片设计及制造、集成电路、封测、材料及设备为一体的半导体产业链展，为半导体国产化产品推动打造一个产学研合作交流平台。

高端会议引领产业趋势：覆盖集成电路芯片设计、半导体材料、5G应用、智能消费电子、汽车电子、无线充电等领域专业性论坛，成为业内线下交流平台。

100+行业媒体宣传：SEMI-e 2022在消费类电子、智能制造、物联网、汽车电子、手机、数码产品、LED照明、集成电路、5G+、半导体等领域的媒体合作、包含芯师爷、今日半导体、电子工程专辑、电子发烧友、《电子与封装》、新材料在线、气体圈子、微电子制造、华强电子网、集微网、半导体行业观察、新浪、今日头条、网易、深圳商报等100行业媒体对展前、展中以及展后持续宣传报道。

展位销售价格：

光地（36平方米起租）：人民币1980元/平方米 美元450美元/平方米

不提供任何家具及电力设施，由参展企业自行设计及搭建展位。

标准展台（9平方米起租）：人民币19800元/个 美元4500美元/个

标准展台内提供以下设备：

公司名称楣板、围板、一张咨询桌、两把折椅、两盏射灯、5A/22V电源插座一个、地毯、展会期间的卫生清洁。